

PLASTICS for the Future.



挑戦

樹脂で、未来を変える。



半導体封止用エポキシ樹脂成形材料

スミコン® EME

スミコン® EME は、AI 半導体の高発熱・高集積化に対応する封止材料。
優れた放熱性と高信頼性を高次元で実現し、データセンターからモビリティ
まで、次世代半導体の進化を支えます。

